厦门市集成电路企业名单确认工作指南

一、申报企业条件

（一）在本市行政区域内具有独立法人资格，符合国家产业发展方向，具有5人以上稳定技术团队（在本市签订劳动合同、缴交社保），有一定数量知识产权和固定研发生产经营场所，项目在本市实施，且经厦门市工业和信息化局（以下简称“市工信局”）确认，专门从事集成电路领域（包括EDA工具、逻辑电路、存储器、特色工艺半导体、宽禁带半导体、微机电系统与智能传感器、基础电子元器件、Mini/Micro LED、OLED、激光显示等）设计、制造、封装测试、装备与材料的研发及生产、公共服务的单位。

（二）申报单位或个人、财务审计机构应在信用厦门平台无提示、警示信息，未列入失信联合惩戒范围，未出现涉黑涉恶问题，未发生重大生产安全责任事故。

二、申报材料

（一）集成电路企业确认评审表（附件1）；

（二）信用承诺书（附件2）；

（三）企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；

（四）汇算清缴最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料；

（五）经具有资质的第三方机构鉴证的上年度企业所得税汇算清缴报告；

（六）所从事的主营业务资质证明材料复印件（根据下列企业类型提供对应材料）：

1.集成电路设计企业：

1. 企业拥有与主营产品相关的已授权发明专利、布图设 计登记、计算机软件著作权登记证书等材料；
2. EDA正版软件使用证明；
3. 芯片设计版图缩略图、产品外观照片；
4. 一至两份代表性流片合同、流片发票以及与主要客户签订的一至两份代表性销售合同等；
5. IC设计团队名单（附件3）；

（6）企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境和经营场所的材料。

2.集成电路制造企业：

（1）制造设备清单（包含类型、型号、功能、用途、厂家等信息）；

（2）与主要客户签订的一至两份代表性合同及收款发票；

（3）企业具有与集成电路制造相适应的经营场所、软硬件 设施等材料（包括但不限于生产车间及厂房照片等相关佐证材料）。

3.集成电路封装测试企业：

（1）封装测试设备清单（包含类型、型号、功能、用途、厂家等信息）；

（2）与主要客户签订的一至两份代表性合同及收款发票；

（3）企业具有与集成电路相适应的经营场所、软硬件设施等材料（包括但不限于封装测试车间及厂房照片等相关佐证材料）。

4.集成电路装备和材料生产及研发企业：

（1）企业开发销售的主要产品列表（名称/规格）、研发生产设备清单；

（2）与主要客户签订的一至两份代表性合同及收款发票；

（3）企业具有与集成电路装备和材料生产相适应的经营场 所、软硬件设施等材料（包括但不限于生产车间及厂房照片等相关佐证材料）。

5.集成电路公共技术服务企业（含第三方IC设计平台）：

（1）软件及设备清单（包含类型、型号、功能、用途、厂家等信息）；

（2）与主要客户签订的服务合同及收费发票（若干）；

（3）企业具有与集成电路公共技术服务相适应的经营场 所、软硬件设施等材料（包括但不限于软件及设备环境照片等相关佐证材料）。

三、申报流程

申报时间与厦门市工业和信息化局关于组织开展2026年厦门市集成电路产业发展专项资金申报工作的通知一致。

（一）网上申报：申报主体使用i厦门法人账号（非市民账号）登录厦门市企业服务总门户“慧企云”平台（网址：https://www.xmsme.cn/），进入“工信企服专区—政策项目，选择2026年厦门市集成电路产业发展专项资金相关申报项目进行申报，核实企业信息并按要求填写和上传相关材料。（注：如没有法人账号，需注册并且认证后才能申报，i厦门认证时间需2-3天，请提前进行相关操作）。

（二）纸质件备查：待申报系统显示申报材料通过预审后，申报主体可登录系统打印相关材料一式一份备查，所有材料须加盖公章，纸质材料应与上传的电子版材料一致。